

Hochschule Aalen

Prof. Dr. Bürkle, 07361 576-2103
E-Mail: heinz-peter.buerkle@htw-aalen.de

Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Prof. Dr. Gerlach, 07431 732-9155
E-Mail: gerlach@hs-alsig.de

Hochschule Esslingen

Prof. Dr. Lindermeir, 0711 397-4230
E-Mail: walter.lindermeir@hs-esslingen.de

Hochschule Furtwangen

Prof. Dr. Benyoucef, 07723 920-2342
E-Mail: benyoucef@hs-furtwangen.de

Hochschule Heilbronn

Prof. Dr. Gessler, 07940 1306-184
E-Mail: gessler@hs-heilbronn.de

Hochschule Karlsruhe

Prof. Dr. Ng, 0721 925-1520
E-Mail: herman-jalli.ng@h-ka.de

Hochschule Konstanz

Prof. Dr. Schick, 07531 206-657
E-Mail: cschick@htwg-konstanz.de

Technische Hochschule Mannheim

Prof. Dr. Giehl, 0621 292-6860
E-Mail: j.giehl@hs-mannheim.de

Hochschule Offenburg

Prof. Dr. Mackensen, 0781 205-4770
E-Mail: elke.mackensen@hs-offenburg.de

Hochschule Pforzheim

Prof. Dr. Kesel, 07231 28-6567
E-Mail: frank.kesel@hs-pforzheim.de

Hochschule Ravensburg-Weingarten

Prof. Dr. Siggelkow, 0751 501-9633
E-Mail: siggelkow@hs-weingarten.de

Hochschule Reutlingen

Prof. Dr. Hennig, 07121 271-7129
E-Mail: eckhard.hennig@reutlingen-university.de

Technische Hochschule Ulm

Prof. Dr. Terzis, 0731 502-8341
E-Mail: Anestis.Terzis@thu.de

Gerne erörtern wir mit Ihnen Wege der Zusammenarbeit.

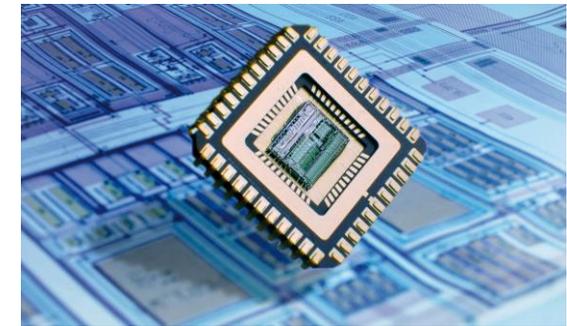
Für den Erstkontakt wenden Sie sich bitte an Ihren MPC-Ansprechpartner am nächstgelegenen Hochschulort.

Sie finden uns auch im Internet unter <http://www.mpc-gruppe.de>



MPC-GRUPPE

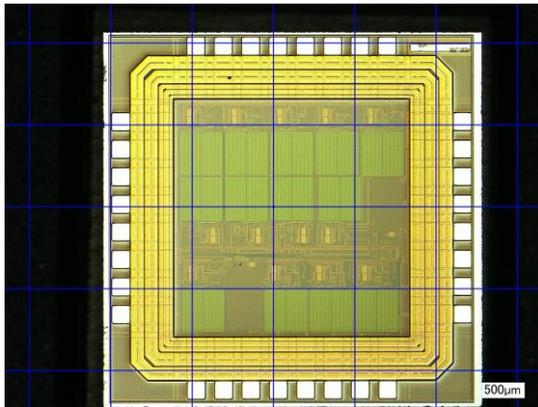
Hochschulen
in
Baden-Württemberg



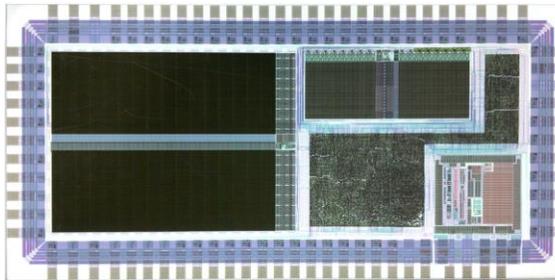
**Multi Projekt Chip
Gruppe**

**Ihr Partner bei der Entwicklung
integrierter Schaltungen**

Die Multi Projekt Chip Gruppe (MPC-Gruppe) ist eine Kooperation, an der sich rund 50 Professoren aus 13 baden-württembergischen Hochschulen beteiligen. Gemeinsam ist uns, dass wir alle das Spezialgebiet *Entwurf und Test monolithisch integrierter Schaltungen* vertreten. Wir vermitteln jährlich ca. 600 künftigen Ingenieuren Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Schaltungsintegration. Ferner ebnen wir mit etwa 100 Bachelor-/Masterarbeiten pro Jahr vielen Unternehmen den Weg für spätere Produkte mit hoch-integrierten Bausteinen.



Verstärker, Filter 3. und 8. Ordnung in AMS S35D4 0.35 µm CMOS 4M/2P, Abmessung 2 x 2 mm²
 [N. Koetsier, F. Bohinsky, A. Zwick, M. Camoleze de Andrade, B. Vettermann, J. Giehl in ISSN 1868-9221, Band 55, S. 1-8, Herausgeber Hochschule Karlsruhe www.mpc-gruppe.de/de/workshopbaende.html].



Plot der Strukturen des ASIC-PDA V2, in einer UMC 0.18 µm CMOS 1P6M-Technologie, Abmessung des Chips 1,52 x 3,16 mm², 241 MIPS, Entwurf Benjamin Dusch u. a., Hochschule Offenburg.

Im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers können wir für Unternehmen noch mehr tun und bieten unsere Hilfe bei der Entwicklung von ASIC's an:

- Beratung bei der Auswahl der geeigneten Integrationsform und Technologie
- Hilfe bei der Entwicklung von Entwurfsbaukästen und Bibliotheken
- Entwurf Ihrer integrierten Schaltungen sowie Beschaffung, Analyse und Spezifikation der Musterschaltungen
- Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter

Wir benutzen Technologien und Bibliotheken bekannter Halbleiterhersteller und sind in der Lage, über EURORACTICE und CMP Muster in den nachstehenden Technologien zu vorteilhaften Konditionen fertigen zu lassen:

- AMS Austria Microsystems 350 und 180 nm CMOS
- Global Foundries 55 und 22 nm
- ON-Semiconductors 350 und 500 nm CMOS A/D Standardzellen und Full Custom
- TSMC 180 nm und 250 nm CMOS-Standardzellen
- UMC 250nm bis 45 nm Standardzellen und Full Custom
- **Alle über Europractice, FhG und CMP** erhältlichen Technologien
- FPGA-Designs für XILINX und ALTERA, GATE ARRAY Technologien div. Anbieter
- IP-Entwicklung (analog/digital) und Portierung auf Ziel-technologien